

# キーワード

---

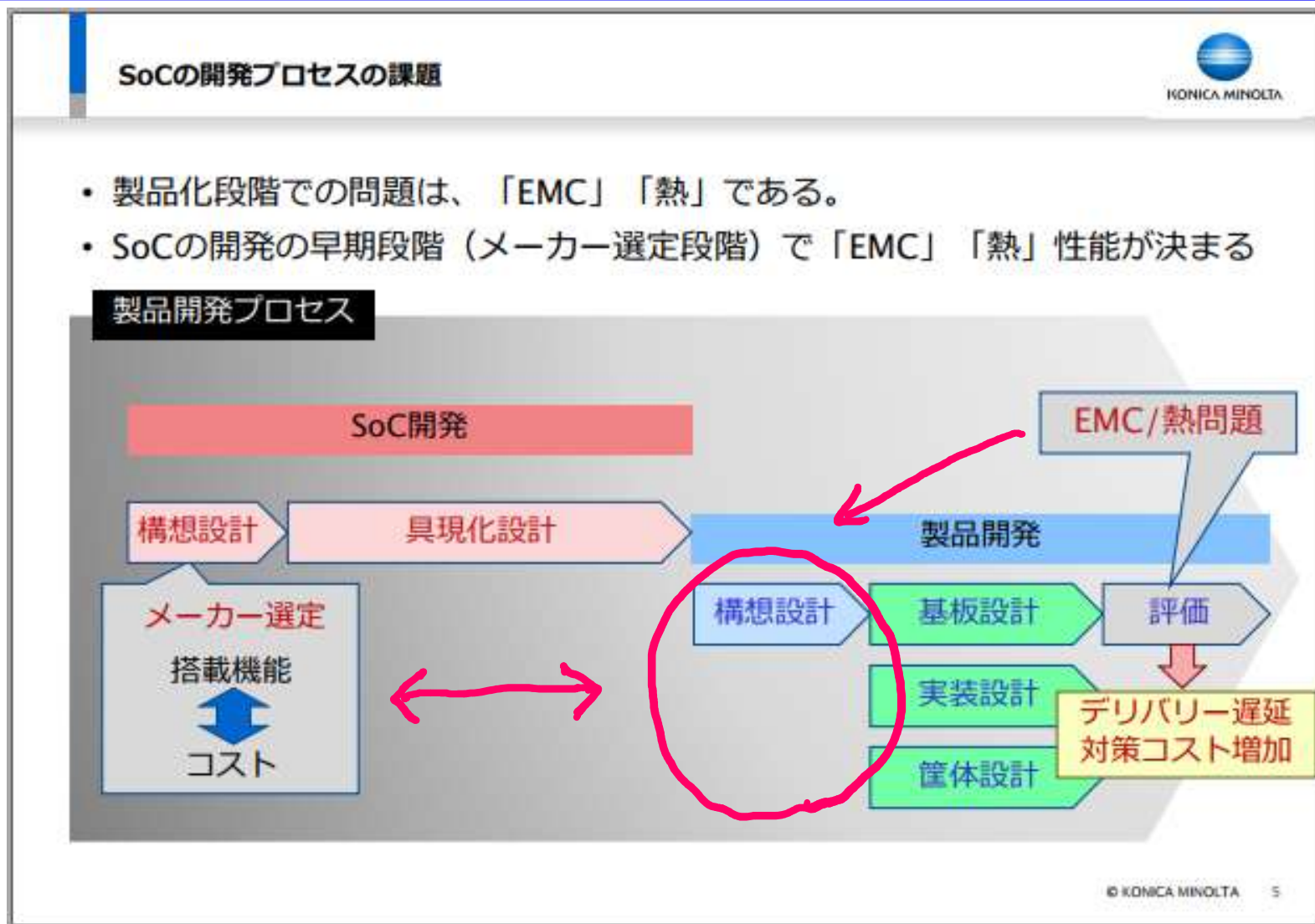
- LPBフォーマット対応 モデル・EDA
- ヘテロジニアスイнтеグレーション
- IBISモデリングとSI/EMI解析
- 熱検討
- マルチドメイン検証・VHDL-AMSモデル
- 半導体とセットメーカーの協調設計
- 設計スタイルのフロントローディング

# キーワード

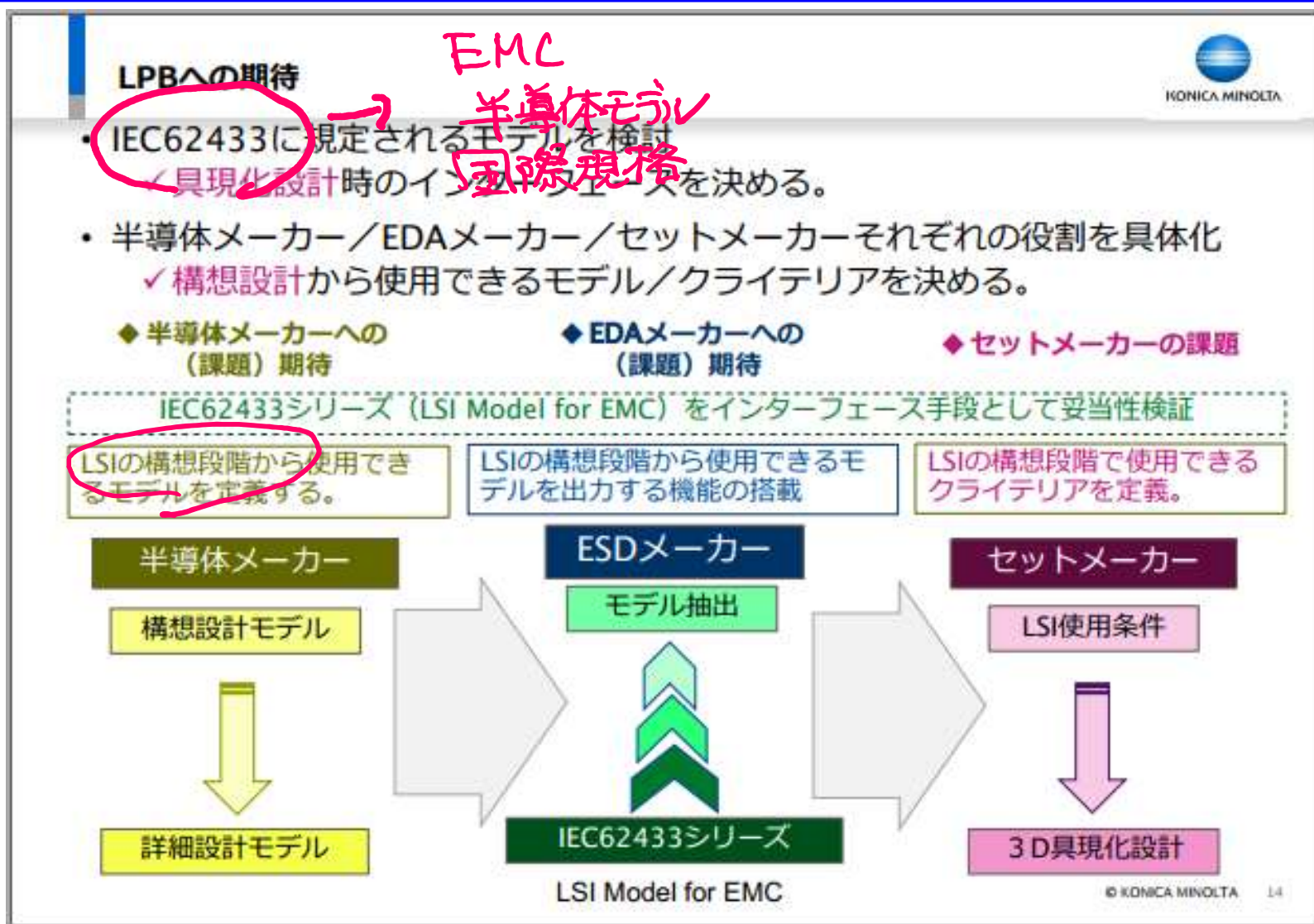
---

- LPBフォーマット対応 **モデル**・EDA
- ヘテロジニアス**インテグレーション**
- **IBISモデリング**と**SI/EMI解析**
- **熱検討**
- **マルチドメイン検証**・**VHDL-AMSモデル**
- 半導体とセットメーカーの**協調設計**
- **設計スタイルのフロントローディング**

# コニカミノルタ 野村様 資料

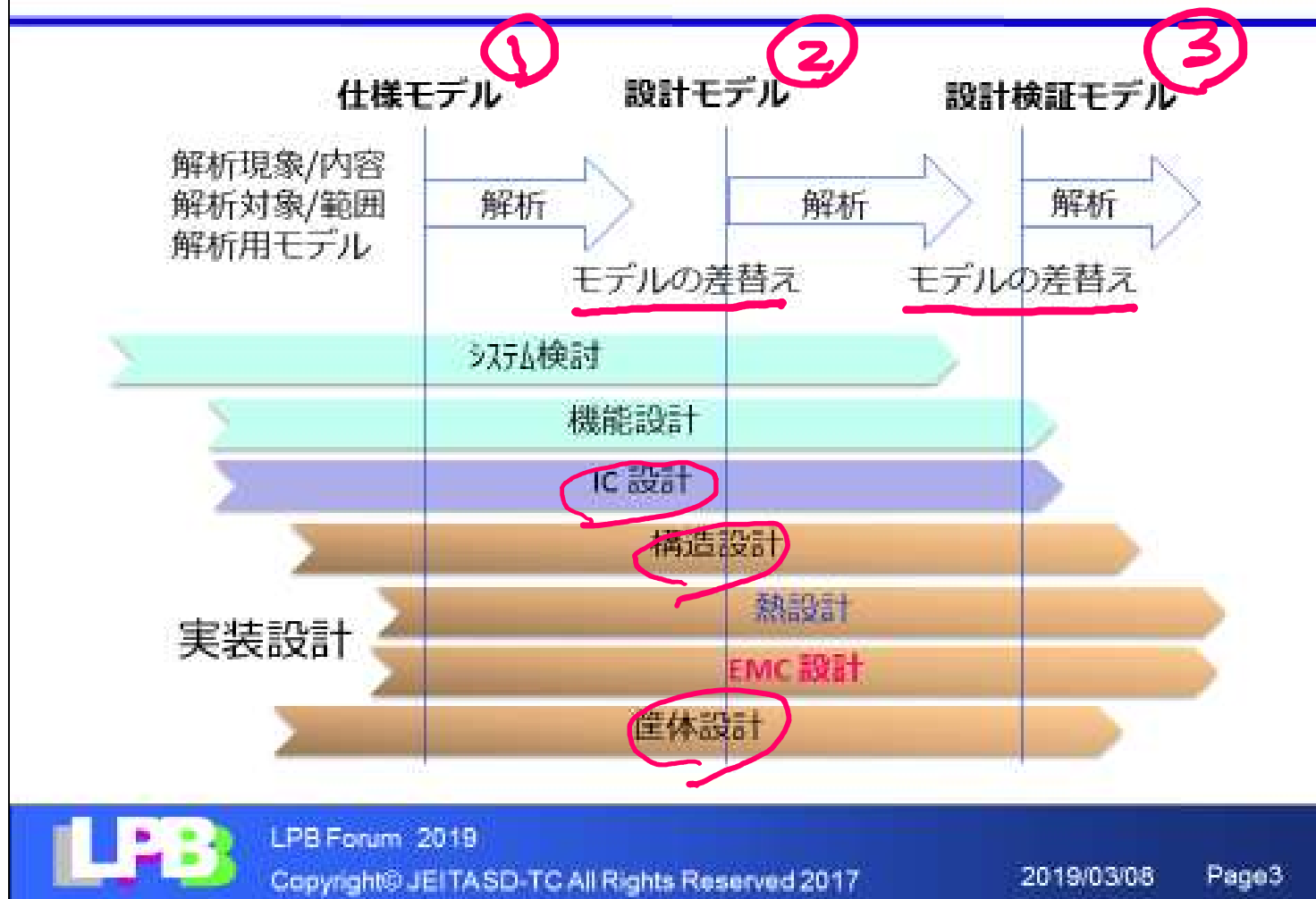


# コニカミノルタ 野村様 資料



# デンソー 市川様資料

## 各要件を構想段階から調整



# デンソー 市川様資料

## MBD – 半導体EMCモデル



欧州でデファクト  
EMC仕様書

	仕様モデル 設計目標モデル	設計モデル	性能検証 モデル
	設計(全体最適化)	確認	検証
ノイズ源	BISSクラス IEC62433	設計結果で モデリング	評価結果で モデリング
内部インピーダンス	設計狙い値	CPM, IBIS IEC62433	IEC62433
耐性	BISSクラス IEC62433		

EMC  
→ 半導体モデル  
国際規格



LPB Forum 2019

Copyright© JEIT ASD-TC All Rights Reserved 2017

2019/03/08

Page2



LPB Forum 2019

Copyright© JEITA SD-TC All Rights Reserved 2017

2019/03/08

Page6

# 最後に

---

- モデル
- 設計フロー
- 解析